

关于 BEEP 模块的技术文档

一、产品简介

采用多晶片集成电路（SOT 塑封装）此集成电路采用金丝球焊接，生产工艺复杂，使用寿命长，性能稳定，产品合格率高。

电压：5V

最大电流：小于等于 30mA/5VDC

谐振频率：2500+-300hz

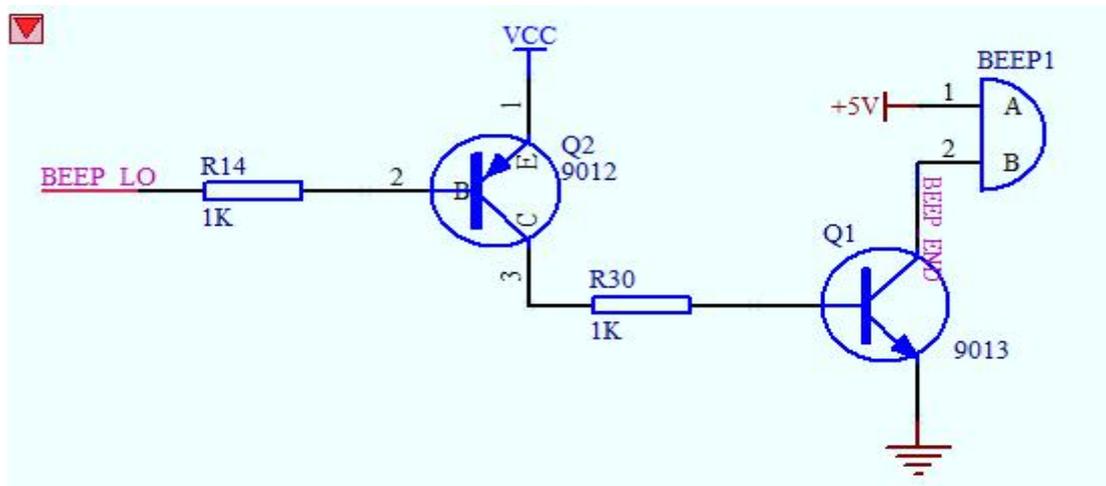
工作温度：-20 到 70 度

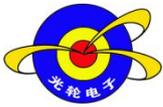
二、硬件调试

(1)、硬件实物图展示如下图：



(2)、模块原理图接口展示如图：





<http://www.treeos.com>

(3) 单片机管脚链接表：详见收到的 AD 工程中 Device For IO Controller 的 BEEP 模块原理图。

三、软件调试

本案例基于光轮电子公司 TreeOS 架构运行，具体软件工程还请关注光轮电子公司 TreeOS 驱动库文件。

